

DIN EN 61837-3

ICS 31.240

Einsprüche bis 2013-07-27
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 61837-3:2001-09

Entwurf

**Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion –
Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse –
Teil 3: Metallgehäuse
(IEC 49/1030/CD:2013)**

Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 3: Metal enclosure
(IEC 49/1030/CD:2013)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-05-27 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an dke@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 41 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Inhalt

	Seite
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Konfiguration der Gehäuse	5
4 Bezeichnung der Bauformen	5
5 Maße der Metallgehäuse	6
6 Anschlussbelegungen	6
7 Bezeichnung der Metallgehäuse	6
Anhang A (informativ) Literaturhinweise	20

Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 49/1030/CD:2013 „Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection – Standard outlines and terminal lead connections – Part 3: Metal enclosure“ (CD, en: Committee Draft) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthält eine noch nicht autorisierte deutsche Übersetzung.

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 49 „Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate beträgt, und dann keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine „JA/NEIN“-Entscheidung möglich ist, wobei eine „NEIN“-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der CD als DIN-Norm-Entwurf veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit frühzeitig berücksichtigen zu können.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 642 „Piezoelektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61837-3:2001-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Alle Abschnitte wurden unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe entsprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung überarbeitet.
- b) Die Gehäusezeichnungen wurden überarbeitet.
- c) Die Maße der Anschlussflächen, die in der 1. Ausgabe mit den Mindestwerten angegeben wurden, sind in der überarbeiteten Fassung zur Vereinfachung für den Verbraucher mit den Maximalwerten anzugeben.

Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und - selektion – Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse – Teil 3: Metallgehäuse

Gegenüber der vorherigen Ausgabe enthält diese Ausgabe die folgenden wesentlichen technischen Änderungen:

- Für die Gehäusezeichnung wird festgelegt, dass ein Zeichnungssatz vier Ansichten umfasst: die Draufsicht, die Vorderansicht, die Seitenansicht von rechts und die Ansicht von unten; in der vorherigen Fassung war die Angabe der Seitenansicht von rechts wahlfrei.
- Die Gehäusehöhe (G_1) entfällt in dieser Fassung; stattdessen wird die Gesamthöhe mit dem Symbolbuchstaben G oder mit G und einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl angegeben.
- Gibt es mehrere identische Gehäuse mit unterschiedlicher Höhe (G) oder unterschiedlicher Länge (F) usw., dann ist der Symbolbuchstabe mit einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl, z. B. G_1 , G_2 , F_1 , F_2 usw., anzugeben.
- Die Abstände der Anschlüsse zueinander müssen von Mitte zu Mitte angegeben werden, wobei das Grundmaß e $2,54 \times n$ mm (n : ganze Zahl) bzw. $1,27 \times n$ mm bei Gehäusemaßen kleiner als 6 mm beträgt. (Siehe IEC 61240, 5.5.) Entspricht der Abstand zwischen den Anschlüssen keinem Vielfachen des Grundmaßes, dann ist e mit einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl, z. B. e_1 , e_2 , anzugeben. Gibt es mehrere Abstandswerte, müssen der tiefgestellten Zahl ein Bindestrich und eine Zahl, z. B. e_{1-1} , e_{1-2} usw., folgen.
- Die Maße der Anschlussflächen, die in der 1. Ausgabe mit den Mindestwerten angegeben wurden, sind in der überarbeiteten Fassung zur Vereinfachung für den Verbraucher mit den Maximalwerten anzugeben.
- Gibt es mehrere identische Gehäuse mit unterschiedlicher Höhe, wird jedes Gehäuse mit einem Schrägstrich (/) und einer zweistelligen Zahl hinter der Bezeichnung der Grundbauform angegeben. Die Bezugskennzeichnungen werden in der Tabelle im Datenblatt angegeben. Alle entsprechenden Gehäuse sind in Tabelle 1 aufgeführt.
- Zeichnungen in derselben Größe sollten im selben Maßstab angegeben werden. Der Maßstab sollte grundsätzlich nach der folgenden Tabelle bestimmt werden (siehe IEC 61240, Anhang A).

Tabelle A.1 – Maßstab der Zeichnungen

Nennwert von A	Maßstab
$10 \text{ mm} \leq \text{Nennwert}$	3:1
$5 \text{ mm} \leq \text{Nennwert} < 10 \text{ mm}$	5:1
$\text{Nennwert} < 5 \text{ mm}$	10:1

- Die folgenden Gehäuse wurden hinsichtlich einiger Bezugsgrößen überarbeitet, wie in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 – Maßänderungen in der 2. Ausgabe

Bauform	Blatt-Nr.	Beschreibung
SS-L4/01 ~ 03	Blatt 1	Der Maximalwert für L_{P1} wurde von 1,2 mm auf 1,4 mm erhöht.
SS-L4/04 ~ 07	Blatt 2	Der Maximalwert für B_1 wurde von 9,5 mm auf 9,6 mm erhöht. Der Maximalwert für L_{P1} wurde von 1,2 mm auf 1,4 mm erhöht.
SS-J2/01 ~ 02	Blatt 12	Der Maximalwert für B wurde von 4,7 mm auf 5,0 mm erhöht. Der Mindestwert für K_1 wurde von 0,85 mm auf 0,6 mm verringert.

Einleitung

IEC 61837-3, 2. Ausgabe, legt die Gehäusemaße und Anschlüsse für oberflächenmontierbare Metallgehäuse von Quarzbauteilen fest. Dieses Dokument basiert auf IEC 61240, 2. Ausgabe, in der die Gestaltungsregeln für Gehäusezeichnungen von oberflächenmontierbaren Bauelementen genormt sind.

In der vorherigen Ausgabe von IEC 61240 (1. Ausgabe) beruhten die allgemeinen Regeln auf IEC 60191-6:1990, die die mechanische Normung von Halbleiterbauelementen festlegte. Es gab jedoch einige Schwierigkeiten, die Gehäuse von Quarzbauteilen unter Anwendung derselben Regeln, wie sie für Halbleiterbauelemente gelten, zu beschreiben. Deshalb wurde auf der Sitzung in Dresden vorgeschlagen, die allgemeinen Regeln unter Berücksichtigung der Gestaltungsregeln der ISO zu überarbeiten. Die zweite Ausgabe von IEC 61240 wurde 2012 veröffentlicht.

Auf der Sitzung in Stanford im Jahr 2010 wurde vorgeschlagen, die Überarbeitung von IEC 61837-3, Ausgabe 1.0, zwecks Änderung der Gehäusezeichnungen früher als vorgesehen durchzuführen, und dieser Vorschlag wurde angenommen (49/950/DC), wobei die Gehäusezeichnungen entsprechend den allgemeinen Regeln modifiziert werden sollten. Das Japanische Nationale Komitee (JNC) hat daher mit der Verteilung des Überprüfungsberichts (49/1019/RR) die vorgezogene Überarbeitung beschlossen.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61837 basiert auf IEC 61240, 2. Ausgabe, und beschreibt Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse, wie sie für SMDs zur Frequenzstabilisierung und -selektion in Metallgehäusen gelten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 61240:2012, *Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection – General rules*

3 Konfiguration der Gehäuse

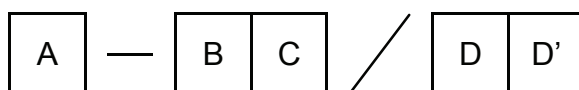
Die Gehäuse der oberflächenmontierbaren Bauteile sind aus Metall hergestellt, wobei ihre geformten Anschlüsse auf dem beschreibenden Kennzeichnungssystem für Halbleitergehäuse basieren.

Bei den SMD-Gehäusen nach Teil 3 handelt es sich in allen Fällen um SS-Bauformen. Daher lautet das Konfigurationssymbol wie folgt:

- SS (special surface-mounted).

4 Bezeichnung der Bauformen

Die Bezeichnung der Bauformen setzt sich aus den folgenden vier Teilen zusammen:



A: Konfigurationssymbol der Gehäuse:

- SS (special surface-mounted).

B: Struktur der Anschlussdrähte:

- L: Bauform mit gefalzten Anschlüssen;
- J: Bauform mit gefalzten Anschlüssen.

Unbedrahtete Bauformen haben keine Kennzeichnung.

(Siehe IEC 61240, Abschnitt 3, Einteilung der SMD-Gehäuse.)

C: Anzahl der Anschlüsse

D: zweistellige Seriennummer

5 Maße der Metallgehäuse

Die in dieser Norm angegebenen Maße gelten für alle fertiggestellten SMD-Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion. Nur die Maße sind angegeben, die die Anforderungen der IEC 61240 erfüllen.

- Gibt es mehrere identische Gehäuse mit unterschiedlicher Höhe (G) oder unterschiedlicher Länge (F) usw., dann ist der Symbolbuchstabe mit einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl, z. B. G_1 , G_2 , F_1 , F_2 usw., anzugeben.
- Die Abstände der Anschlüsse zueinander müssen von Mitte zu Mitte angegeben werden, wobei das Grundmaß e $2,54 \times n$ mm (n : ganze Zahl) bzw. $1,27 \times n$ mm bei Gehäusemaßen kleiner als 6 mm beträgt. (Siehe IEC 61240, 5.5.) Entspricht der Abstand zwischen den Anschlüssen keinem Vielfachen des Grundmaßes, dann ist e mit einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl, z. B. e_1 , e_2 , anzugeben. Gibt es mehrere Abstandswerte, müssen der tiefgestellten Zahl ein Bindestrich und eine Zahl, z. B. e_{1-1} , e_{1-2} usw., folgen.
- Gibt es mehrere identische Gehäuse mit unterschiedlicher Höhe, wird jedes Gehäuse mit einem Schrägstrich (/) und einer zweistelligen Zahl hinter der Bezeichnung der Grundbauform angegeben. Die Bezugskennzeichnungen werden in der Tabelle im Datenblatt angegeben.

6 Anschlussbelegungen

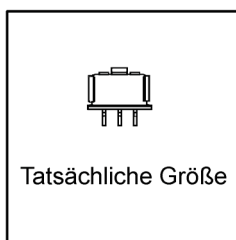
Da SS-Gehäusebauformen spezielle SMD-Ausführungen sind, werden für sie keine Anschlussbelegungen festgelegt. Anschlussbelegungen aber müssen immer nach Vereinbarung mit dem Kunden in der Bauartspezifikation angegeben werden.

7 Bezeichnung der Metallgehäuse

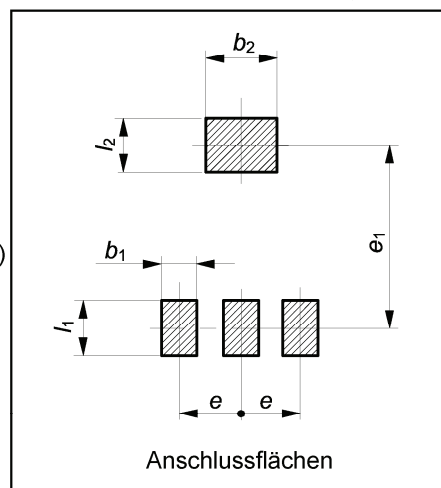
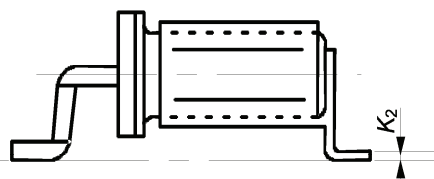
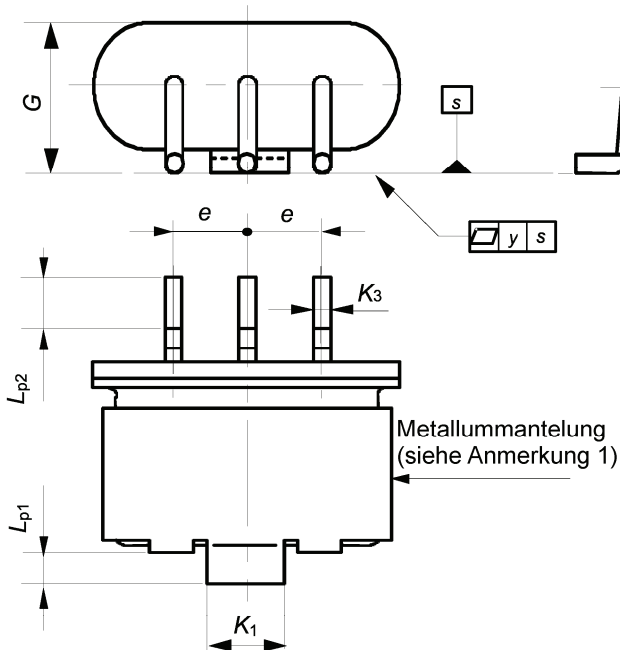
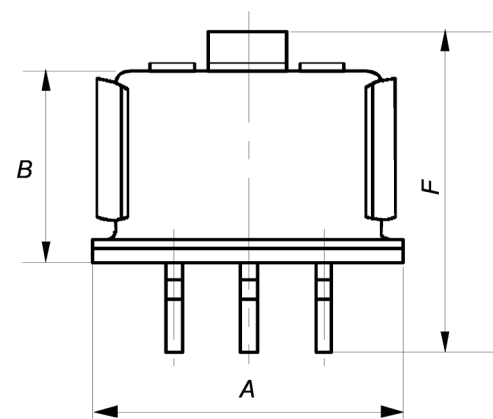
Die folgende Tabelle gibt die Bezeichnung der in den nachfolgenden Normblättern dargestellten Metallgehäuse an. Alle entsprechenden Gehäuse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 2 – Bezeichnung der Metallgehäuse

Nr.	Bauform	Blatt-Nummer	Beschreibung
1	SS-L4/01	Blatt 1	Metall, widerstandsgeschweißt, vier gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
2	SS-L4/02		
3	SS-L4/03		
4	SS-L4/04	Blatt 2	Metall, widerstandsgeschweißt, vier gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
5	SS-L4/05		
6	SS-L4/06		
7	SS-L4/07		
8	SS-L3/01	Blatt 3	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
9	SS-L3/02		
10	SS-L3/03		
11	SS-L3/04	Blatt 4	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
12	SS-L3/05		
13	SS-L3/06	Blatt 5	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
14	SS-L3/07		
15	SS-L3/08		
16	SS-L3/09	Blatt 6	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
17	SS-L3/10		
18	SS-L3/11		
19	SS-L3/12	Blatt 7	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
20	SS-L3/13		
21	SS-L3/14		
22	SS-L3/15	Blatt 8	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
23	SS-L3/16		
24	SS-L3/17		
25	SS-L3/18		
26	SS-L3/19		
27	SS-L3/20		
28	SS-L3/21	Blatt 9	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
29	SS-L3/22		
30	SS-L3/23		
31	SS-L3/24		
32	SS-L3/25	Blatt 10	Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
33	SS-L3/26		
34	SS-L3/27		
35	SS-J4/01	Blatt 11	Metall, widerstandsgeschweißt, Kunststoffträger, vier gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
36	SS-J2/01	Blatt 12	Metall, widerstandsgeschweißt, Kunststoffträger, zwei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage
37	SS-J2/02		



Bezug	Maße in mm			Bemerkungen
	min.	nenn.	max.	
A	—	—	8,26	
B ₁	—	—	5,10	/01
B ₂	—	—	6,40	/02
B ₃	—	—	8,80	/03
F ₁	—	—	9,50	/01
F ₂	—	—	10,80	/02
F ₃	—	—	12,75	/03
G	—	—	4,00	
K ₁	1,75	—	2,25	
K ₂	0,15	—	0,30	
K ₃	0,30	—	0,90	Anm. 2
L _{P1}	0,70	—	1,40	
L _{P2}	1,20	—	1,80	
e	—	1,88	—	
e ₁₋₁	—	7,50	—	/01
e ₁₋₂	—	8,80	—	/02
e ₁₋₃	—	10,80	—	/03
b ₁	—	—	0,80	
b ₂	—	—	2,40	
l ₁	—	—	2,30	
l ₂	—	—	2,10	
y	—	—	0,20	

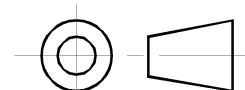


ANMERKUNG 1 Die Anordnung der Metallummantelung ist als Beispiel aufgeführt.

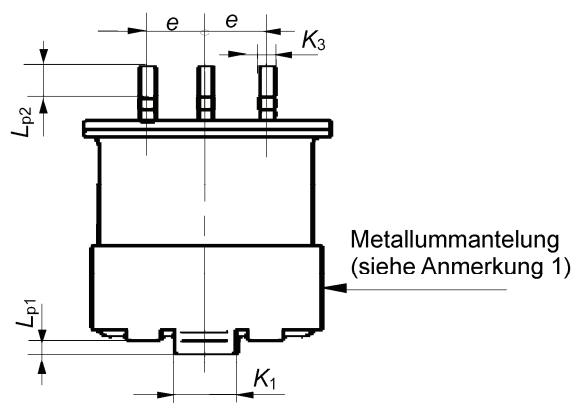
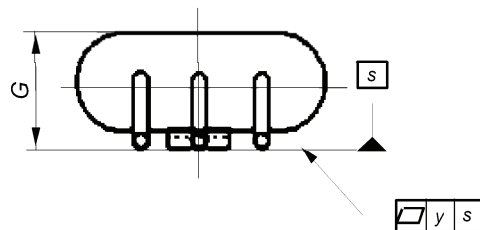
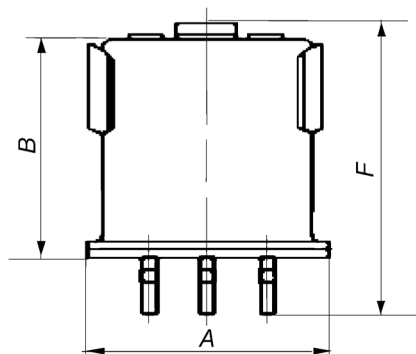
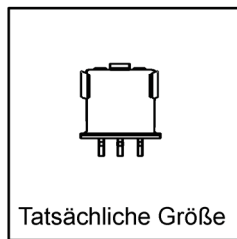
ANMERKUNG 2 Dieser Teil des Anschlusses kann unter Druck umgeformt werden.

Metall, widerstandsgeschweißt, vier gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage – Bauform SS-L4/01 ~ 03

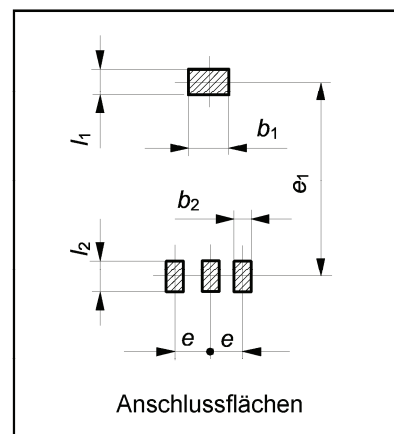
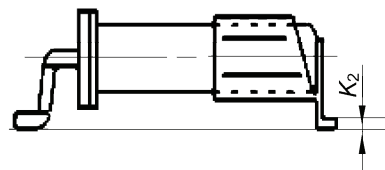
Maßstab
5:1



Blatt 1



Bezug	Maße in mm			Bemerkungen
	min.	nenn.	max.	
A	—	—	11,05	
B ₁	—	—	9,60	/04
B ₂	—	—	10,70	/05
B ₃	—	—	11,40	/06
B ₄	—	—	13,50	/07
F ₁	—	—	14,30	/04
F ₂	—	—	15,50	/05
F ₃	—	—	16,20	/06
F ₄	—	—	18,30	/07
G	—	—	5,30	
K ₁	2,90	—	3,10	
K ₂	0,15	—	0,30	
K ₃	0,38	—	1,10	Anm. 2
L _{P1}	0,70	—	1,40	
L _{P2}	1,00	—	1,70	
e	—	2,44	—	
e ₁₋₁	—	11,80	—	/04
e ₁₋₂	—	13,00	—	/05
e ₁₋₃	—	13,70	—	/06
e ₁₋₄	—	16,00	—	/07
b ₁	—	—	5,00	
b ₂	—	—	1,40	
l ₁	—	—	1,80	
l ₂	—	—	3,00	
y	—	—	0,20	

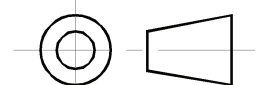


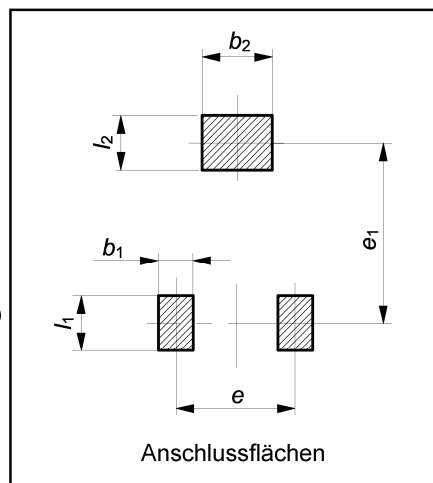
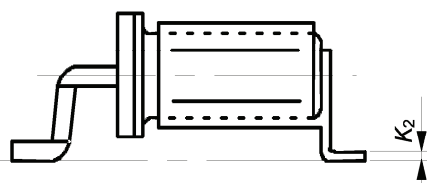
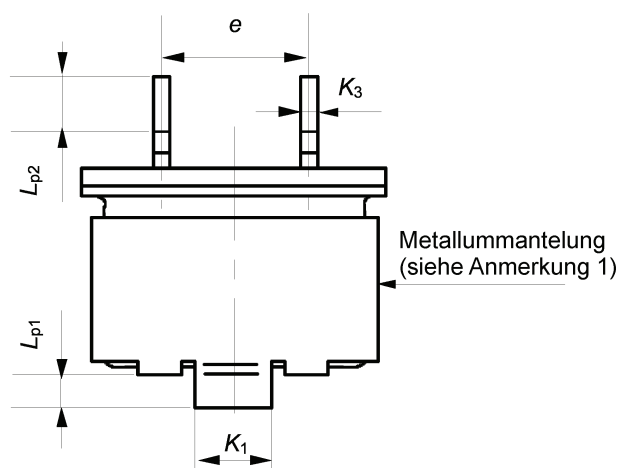
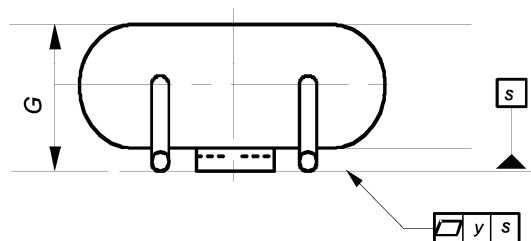
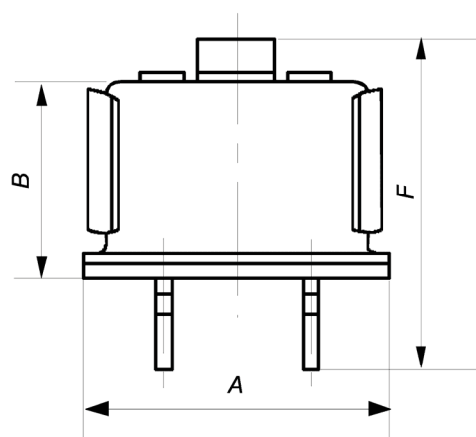
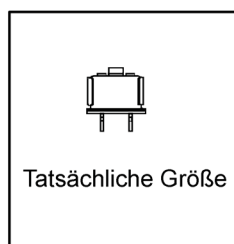
ANMERKUNG 1 Die Anordnung der Metallummantelung ist als Beispiel aufgeführt.

ANMERKUNG 2 Dieser Teil des Anschlusses kann unter Druck umgeformt werden.

Metall, widerstandsgeschweißt, vier gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage – Bauform SS-L4/04 ~ 07

Maßstab
3:1





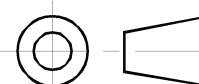
Bezug	Maße in mm			Bemerkungen
	min.	nenn.	max.	
A	—	—	8,26	
B ₁	—	—	5,10	/01
B ₂	—	—	6,40	/02
B ₃	—	—	8,80	/03
F ₁	—	—	9,50	/01
F ₂	—	—	10,80	/02
F ₃	—	—	12,75	/03
G	—	—	4,00	
K ₁	1,75	—	2,25	
K ₂	0,15	—	0,30	
K ₃	0,30	—	0,90	Anm. 2
L _{P1}	0,70	—	1,20	
L _{P2}	1,20	—	1,80	
e	—	3,75	—	
e ₁₋₁	—	7,50	—	/01
e ₁₋₂	—	8,80	—	/02
e ₁₋₃	—	10,80	—	/03
b ₁	—	—	0,80	
b ₂	—	—	2,40	
l ₁	—	—	2,30	
l ₂	—	—	2,10	
y	—	—	0,20	

ANMERKUNG 1 Die Anordnung der Metallummantelung ist als Beispiel aufgeführt.

ANMERKUNG 2 Dieser Teil des Anschlusses kann unter Druck umgeformt werden.

Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage – Bauform SS-L3/01 ~ 03

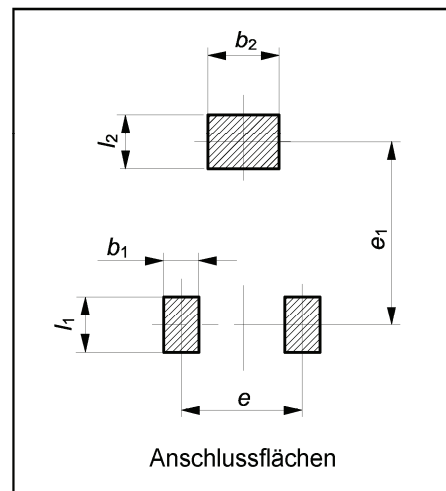
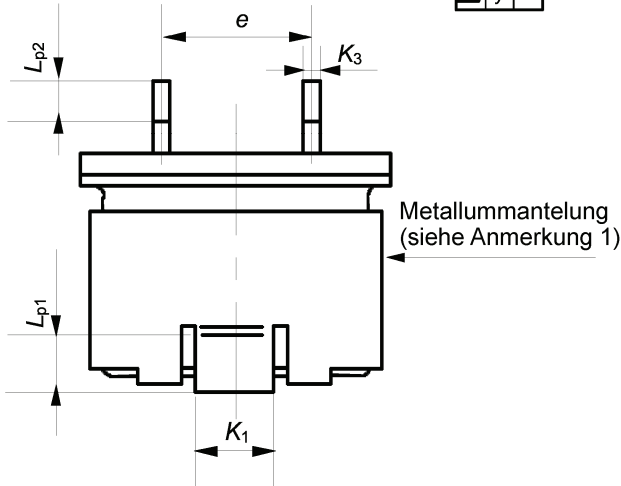
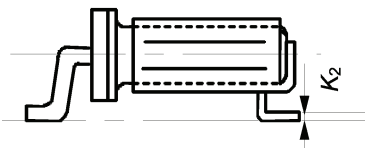
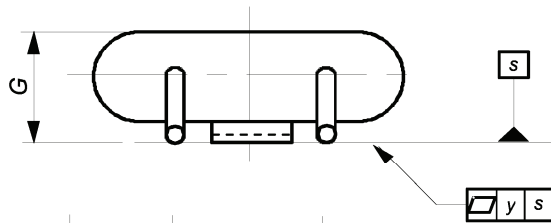
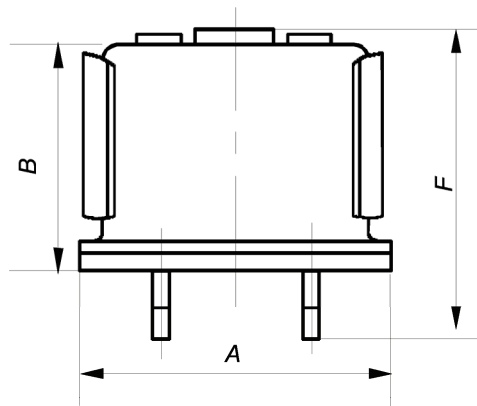
Maßstab
5:1



Blatt 3



Bezug	Maße in mm			Bemerkungen
	min.	nenn.	max.	
A	—	—	8,26	
B ₁	—	—	6,00	/04
B ₂	—	—	8,00	/05
F ₁	—	—	8,20	/04
F ₂	—	—	10,20	/05
G	—	—	3,00	
K ₁	1,75	—	2,25	
K ₂	0,15	—	0,30	
K ₃	0,30	—	0,50	Anm. 2
L _{P1}	0,70	—	1,20	
L _{P2}	1,00	—	1,30	
e	3,50	3,75	4,00	
e ₁₋₁	—	6,80	—	/04
e ₁₋₂	—	8,80	—	/05
b ₁	—	—	0,80	
b ₂	—	—	2,60	
l ₁	—	—	2,10	
l ₂	—	—	1,70	
y	—	—	0,20	

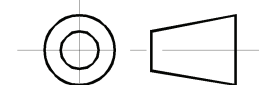


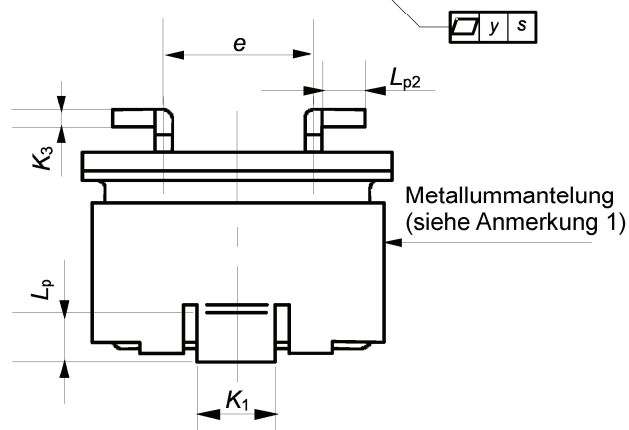
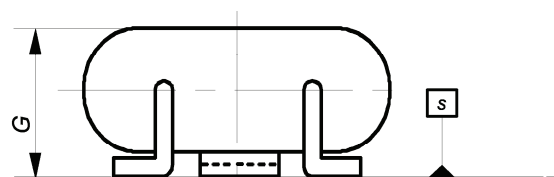
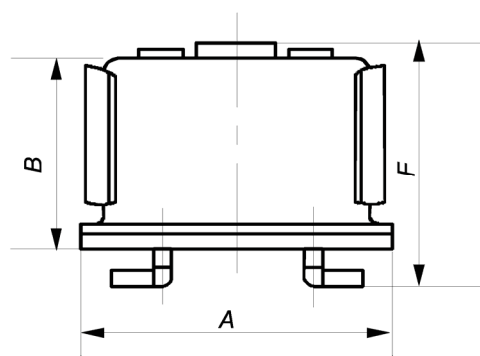
ANMERKUNG 1 Die Anordnung der Metallummantelung ist als Beispiel aufgeführt.

ANMERKUNG 2 Dieser Teil des Anschlusses kann unter Druck geformt werden.

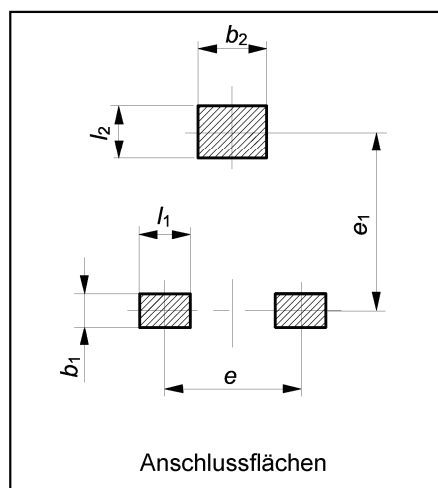
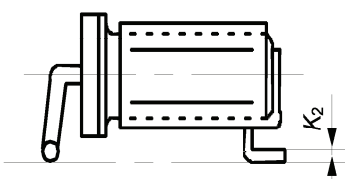
Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage – Bauform SS-L3/04 ~ 05

Maßstab
5:1





Bezug	Maße in mm			Bemerkungen
	min.	nenn.	max.	
A	—	—	8,26	
B ₁	—	—	5,10	/06
B ₂	—	—	6,00	/07
B ₃	—	—	8,00	/08
F ₁	—	—	6,20	/06
F ₂	—	—	8,00	/07
F ₃	—	—	10,00	/08
G	—	—	4,00	
K ₁	1,75	—	2,25	
K ₂	0,15	—	0,30	
K ₃	0,30	—	0,50	Anm. 2
L _{P1}	0,70	—	1,20	
L _{P2}	0,80	—	1,60	
e	5,30	5,60	5,90	
e ₁₋₁	—	5,00	—	/06
e ₁₋₂	—	5,90	—	/07
e ₁₋₃	—	7,90	—	/08
b ₁	—	—	2,60	
b ₂	—	—	0,80	
l ₁	—	—	1,70	
l ₂	—	—	2,10	
y	—	—	0,20	

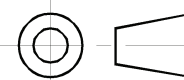


ANMERKUNG 1 Diese Anordnung der Metallummantelung ist als Beispiel aufgeführt.

ANMERKUNG 2 Dieser Teil des Anschlusses kann unter Druck umgeformt werden.

Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage – Bauform SS-L3/06 ~ 08

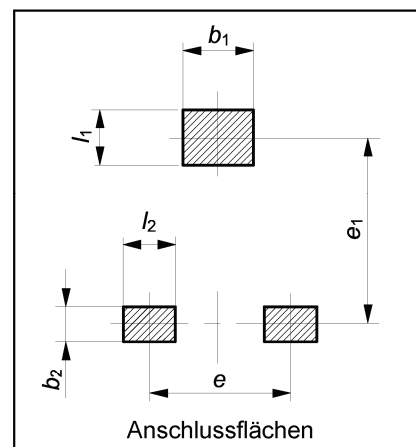
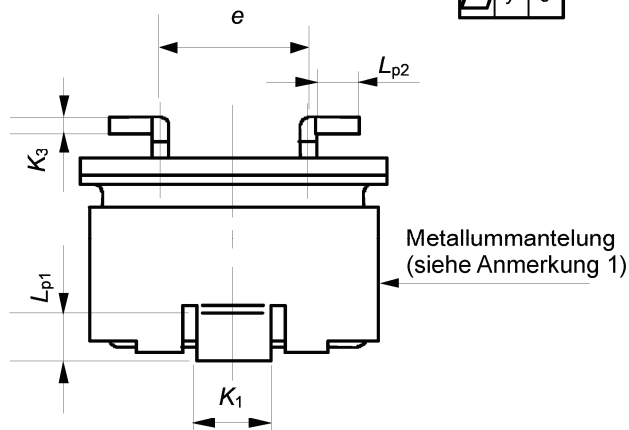
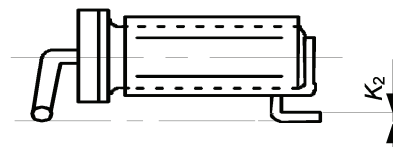
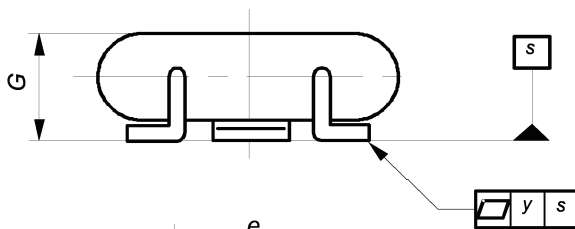
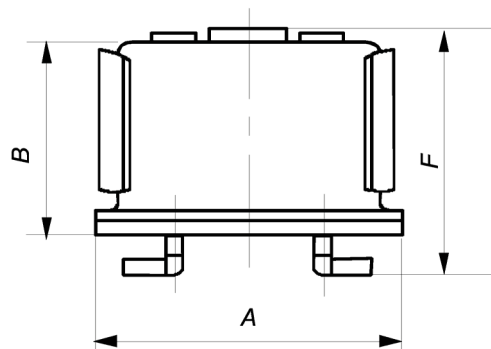
Maßstab
5:1



Blatt 5



Bezug	Maße in mm			Bemerkungen
	min.	nenn.	max.	
A	—	—	8,26	
B ₁	—	—	5,10	/09
B ₂	—	—	6,00	/10
B ₃	—	—	8,00	/11
F ₁	—	—	7,70	/09
F ₂	—	—	8,00	/10
F ₃	—	—	10,00	/11
G	—	—	3,00	
K ₁	1,75	—	2,25	
K ₂	0,15	—	0,30	
K ₃	0,30	—	0,50	Anm. 2
L _{p1}	0,70	—	1,20	
L _{p2}	0,80	—	1,60	
e	5,30	5,60	5,90	
e ₁₋₁	—	5,00	—	/09
e ₁₋₂	—	5,90	—	/10
e ₁₋₃	—	7,90	—	/11
b ₁	—	—	2,60	
b ₂	—	—	0,80	
l ₁	—	—	1,70	
l ₂	—	—	2,10	
y	—	—	0,20	



ANMERKUNG 1 Die Anordnung der Metallummantelung ist als Beispiel aufgeführt.

ANMERKUNG 2 Dieser Teil des Anschlusses kann unter Druck geformt werden.

Metall, widerstandsgeschweißt, drei gefalzte Anschlüsse für SMD-Montage – Bauform SS-L3/09 ~ 11

Maßstab
5:1

